

2018年度 京セラ株式会社 募集要項

1. 採用予定

【応募資格】

2018年3月 四年制大学卒業及び大学院修了見込みの方
(浪人・留年については原則として計2年以内を目安とさせていただきます)

【採用予定】

理工系 160名 程度

【採用学科】

電気・電子系／情報・通信系／機械系／制御系／物理系／化学系／材料系／その他(知的財産 他)

【求める人材像】

- ・ 夢に向かって果敢にチャレンジし続けられる人
- ・ 素直な心、ひたむきさを持っている人
- ・ グローバルな視点を持っている人
(今後の事業のグローバル展開を踏まえ、目安としてTOEIC600点相当の語学力がある方は、更に歓迎します)

《専攻分野と採用比率目安》

電気・電子／情報・通信系	機械／制御系	化学／材料系	物理系	その他
30%	30%	30%	5%	5%

2. 応募方法

(1) 修士・学部の方の応募方法について

次の2コース(プロダクト別採用コース/職種別採用コース)よりご選択いただき、ご応募ください。

※コースの併願はできませんので、ご了承ください。

※各プロダクト・職種の詳細、応募方法の詳細は添付別紙「応募に際しての留意事項」及び「応募概要」をご参照ください。

【1】プロダクト別採用コース(対象:学校推薦応募者限定)

弊社へ学校推薦応募を検討されている方は、
ご本人の「希望される弊社プロダクト」「技術専門性・応用性」(学部生の場合は「学業の理解度とポテンシャル」)について、
弊社該当部署との適性を事前に「マッチング面談会」にて確認させていただきます。
面談にて、マッチングが成立したプロダクト担当部署への配属を前提に、その後の選考に進んでいただきます。
※①～⑭のうち、2つのプロダクト(第1希望/第2希望)をご選択ください。
※6月1日以降にご応募いただいた場合には、配属先のプロダクトを限定しない採用方法に変更させていただく可能性があります。ご了承下さい。

対象プロダクト:

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| ①ファインセラミック部品 | ②車載用部品・車載カメラ | ③セラミックパッケージ・基板 | ④有機パッケージ・基板 |
| ⑤ケミカル材料 | ⑥切削工具 | ⑦医療機器 | ⑧宝飾・応用商品 |
| ⑨エネルギーデバイス・システム(SOFC・EMS) | ⑩電子部品(コンデンサ、コネクタ、パワーデバイス、水晶デバイス) | ⑪ソフトウェア開発 | ⑬生産技術開発・精機 |
| ⑪プリンティングデバイス | ⑫通信機器 | | |

※研究開発部門につきましては、①～⑭は、各プロダクト部門の中に含まれています。

【2】職種別採用コース(対象:学校推薦・自由応募者どちらでも可)

次の職種においては、職種別に適性マッチングを確認し、該当部門への配属を前提に、その後の選考に進んでいただきます。
※⑮～⑰のうち、1つの職種のみご選択ください。

対象職種: ⑮特許・知的財産 ⑯情報ネットワーク・システムエンジニア ⑰施設管理 ⑱安全防災

(2) 博士の方の応募方法について

ご応募を検討される際は、ご本人からのご連絡をお願いいたします。応募時に、まず論文審査をさせていただきます。
履歴書並びに専門分野に関する論文を弊社担当宛にご郵送ください。論文審査合格の方に、選考のご案内をさせていただきます。
※博士課程の方については随時受付いたします。

(3) 理工系の知識を活用する「営業職」への推薦応募方法について

京セラでは、理工系の知識を活用して「営業職」として活躍いただける方についても、別途推薦でのご応募を受け付けております。
応募・選考方法が通常と異なりますので、ご希望の場合には弊社担当宛にご連絡ください。

(4) 留学生の方の応募方法について

学校推薦で応募を希望される場合には、事前に弊社担当宛にご相談ください。

(5) 自由応募の方の応募方法について

応募コース、選考方法が学校推薦応募方法と異なります。
弊社HPのマイページをご確認の上、ご応募ください。

<技術系採用書類送付・お問い合わせ先>

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
京セラ株式会社 人材開発課(技術採用担当) 田中・今野

E-mail: misato.tanaka.nf@kyocera.jp, konno.shingo.yb@kyocera.jp

TEL: 075-604-3510 (直通)

※各コースへの応募書類ご郵送の際は、封筒に
「〇〇採用コース応募書類在中」とご記載願います

京セラへの応募をお考えの方は

『京セラ プロダクト・職種別合同セミナー』へ
ぜひ、ご参加ください! 各プロダクトより、事業内容や最先端技術
をご紹介します! HPのマイページからご予約下さい。

【全国3か所で開催】

東京 3月23日・24日、4月4日・5日 ※3月23日は機電情報限定

京都 3月22日・26日

博多 3月20日

専攻別募集職種業務内容<機械系> KYOCERA

職種	主な専門性	主な業務内容
研究開発	材料工学/金属材料 固体力学 塑性工学/流体工学 電子顕微鏡学	研究企画創出 新商品開発 新プロセス開発
設計技術	材料工学/機械力学 材料組成学/金属疲労学 3次元CAD作図・解析 破壊力学	コンシューマ製品設計 生産設備設計 金型設計
生産技術	制御工学/ロボット工学 シミュレーション工学 機械工作学/ VE/IE 生産システム学	生産性向上 自動機開発 生産ライン自動化・省力化 新規設備導入
製造技術	燃焼学/伝熱工学/制御工学 耐火材 構造力学/安全工学	量産技術確立/品質向上 プロセス技術開発 設備運転管理/安全衛生管理
品質保証	機械工学全般 信頼性工学	品質評価 性能向上

1

専攻別募集職種業務内容<電気電子系> KYOCERA

職種	主な専門性	主な業務内容
研究開発	電子回路工学/電子材料工学 光物性/薄膜工学 表面物性工学/半導体デバイス工学	研究企画創出 電子材料開発 新商品開発 新プロセス開発
設計技術	回路設計 通信情報工学 画像処理 機構設計	電子部品製品設計 コンシューマ製品回路設計 (デジタル/無線) 機構設計
生産技術	電気電子回路/電気電子材料 通信情報工学 画像処理/ VE/IE /ロボティクス	生産性向上 生産ライン自動化・省力化 新規設備導入
製造技術	電力工学/電気機器工学 デジタル信号処理技術 半導体デバイス技術 FEM解析技術	量産技術確立 品質向上 設備運転管理 プロセス技術開発
品質保証	電気電子全般 信頼性工学	品質評価 性能向上

2

専攻別募集職種業務内容<化学系> KYOCERA

職種	主な専門性	主な業務内容
研究開発	無機化学/有機化学 高分子化学 物理化学/表面科学 ナノ材料	研究企画創出 新材料開発 新商品開発 新プロセス開発
生産技術	化学工学/反応工学 粉流体工学/流動層工学 伝熱工学 電気化学	生産性向上 新規設備導入 成形技術開発 焼成技術開発
製造技術	無機化学/有機化学 化学工学/粉体化学 電気化学 プロセスシステム工学	量産技術確立 品質向上 設備運転管理 安全衛生管理
品質保証	化学全般/信頼性工学	品質保証/性能向上
分析	分析化学/機器分析 分光学 組織解析学	分析技術開発 分析機器仕様開発 品質評価

3

専攻別募集職種業務内容<物理系> KYOCERA

職種	主な専門性	主な業務内容
研究開発	結晶物性工学	研究企画創出
開発設計	電磁応用工学 固体表面科学 機能デバイス エネルギー物理学 半導体工学	新材料開発 新商品開発 新プロセス開発
製造技術	応用物理学 材料工学 薄膜工学	量産技術確立 品質向上 生産性向上
品質保証	物理学全般 信頼性工学	品質評価 性能向上
分析	ナノ物理学 分光物理学 電子・分光計測学	分析技術開発 分析機器仕様開発 品質評価

4

職種	主な専門性	主な業務内容
開発設計	通信情報工学 信号処理 通信プロトコル ソフトウェア開発 C言語/C++言語 エンタープライズシステム構築	コンシューマ製品開発 機器ソフトウェア開発 装置ソフトウェア開発
研究開発	信号処理技術 計測工学 ソフトウェア技術	ソリューション研究
UI	情報デザイン インタラクションデザイン 人間工学/デザイン工学	UI設計・評価
社内SE	情報処理技術	基幹系業務システム構築 ITインフラ整備

「プロダクト別採用コース」 応募概要

※プロダクト別採用コースについては、学校推薦応募をお考えの方に限定させていただきます。

STEP.1 マッチング面談会

STEP.2 最終選考

◆マッチング面談会の内容：

ご希望のプロダクト（第2希望まで）の部門責任者と面談
※面談結果は、面談終了後、2週間以内に就職担当教授
もしくはキャリアセンター様へフィードバックさせて
いただきます。

(1) 面談会申込方法

1.大学 ⇒弊社へご連絡	就職担当教授もしくはキャリアセンター様より面談会 参加希望学生を弊社担当までご連絡ください。 <面談会申込連絡内容> ①学生氏名 ②学部/研究科名 ③学科/専攻名 ④就職担当教授もしくはキャリアセンターのご連絡先 をメール又はお電話で弊社担当へご連絡ください。
2.本人 ⇒弊社HPから エントリー	弊社新卒採用HPへエントリーください。 <京セラ採用HP URL: http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/ >
3.本人 ⇒弊社HPから 応募データ入力	弊社HPの「マイページ」より、次の3点を入力し、データ送信ください。 ①「自己紹介シート」 ※面談資料として使用します ②「成績情報」 ※修士の方は学部分も必要です ③「面談結果連絡先(就職担当教授・キャリアセンター等)」 ※自己紹介シートについては、研究概要等も入力いただくため、 ボリュームがあります。入力の際は余裕を持って行ってください。
4.本人 ⇒データ送信 連絡	データ送信されましたら、弊社担当 田中・今野までメールにて ご連絡ください。 ※メールの送り先はお問い合わせ先参照

(2) 面談会申込締切

第1回受付× 4月13日(木) データ送信到着分まで
第2回受付× 5月9日(火) データ送信到着分まで
第3回受付× 6月12日(月) データ送信到着分まで

☆各日程ともに、時間は23:59までのデータ送信分を受付いたします。

(3) 面談会開催日程 ※予定

第1回受付の方 4月22日もしくは23日
第2回受付の方 5月20日もしくは21日
第3回受付の方 6月中旬以降

※面談にご参加いただく日程については、お選びいただくことはできません。
※選択されたプロダクトによっては面談が2日間にまたがる場合もあります。
予めご了承ください。

(4) 面談場所

京都本社を予定しています。
※一部都合により変更する場合があります。

(5) 交通費について

遠方者につきましては、弊社規定により交通費を補助いたします。
(詳細は面談日時ご案内時にご連絡いたします)

(6) マッチング面談会参加準備

1.弊社 ⇒本人へ日程 のご連絡	応募データが到着後、弊社より面談の日時・場所・WEB検査や SPI検査について、マイページ及びメールにてご連絡いたします。
2.本人 ⇒Web適性検査・ SPI検査の受検	面談日の2日前までに、次の検査を受検ください。 ①弊社HPのマイページより「WEBテスト・適性検査」を受検ください。 ②SPIテストセンターにて「SPI検査」を受検ください。
3.本人 ⇒面談資料作成	◆下記資料3点を面談日当日にご持参ください。 ※技術PR資料、自己PR資料、成績証明書(学部・修士)の原紙 (推薦書を当日ご持参可能な方は、併せてご持参ください。) ①技術PR資料 (A4/1~3枚、形式自由) ⇒ご自身の研究内容についてのPR資料 ②自己PR資料 (A4/1枚、形式自由) ⇒研究内容以外で自分を紹介するPR資料 面談当日、各10部ご持参ください。 ※当日は、事前に送信いただいた「自己紹介シート」「成績情報」と ご持参いただいた資料をもとに、面談を実施いたします。 ③成績証明書(学部・修士)を各1部ご持参ください。

(7) マッチング面談会結果フィードバックについて

面談終了後、2週間以内に、マッチング結果を就職担当教授もしくは
キャリアセンター様へ電話もしくはメールにてフィードバックさせて
いただきます。

(8) ご推薦

学校推薦を確定いただき、最終選考の準備をしてください。

◆最終選考内容：面接

※原則として、面談でマッチング成立となった
プロダクト担当部署への配属を前提として、選考を行います。

(1) 最終選考応募方法

1.本人 ⇒応募書類を 郵送	マッチング成立ご連絡後、弊社所定の期日までに 次の「最終選考必要書類」を弊社担当までご郵送ください。 ※期日は、成立された方にそれぞれご案内いたします。 <最終選考応募書類> ①推薦書 ②修了見込証明書 ※後日送付可 ③健康診断書 ※後日送付可 ※推薦書は、学部長・就職担当教授・指導教授のいずれ の方からでも結構です。 ※郵送は就職担当教授・キャリアセンター様・ご本人のいずれ の方からでも結構です。
----------------------	---

(2) 最終選考参加準備

1.弊社 ⇒本人へ日程 のご連絡	最終選考日が決定次第、弊社より日時・場所をご本人へ メールにてご連絡いたします。
<応募に際しての注意事項> ◆マッチング面談成立後、最終選考への応募が遅れた場合には 本コースで受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。 (本コースのプロダクトごとの採用充足状況により、予告なく募集を 締切らせていただく場合がございます。) ◆大学側のご都合により、マッチング成立後、推薦応募までの日数が かかる場合には、事前に弊社担当へご相談下さい。	

(3) 最終選考日程

6月以降随時
※応募書類が到着した順にご本人へ選考の詳細をご案内いたします。

(4) 最終選考場所

東京、京都、博多を予定

(5) 交通費について

最終選考については、弊社規定によりご自宅から面接会場までの
交通費を全額支給いたします。

<技術系採用書類送付・お問い合わせ先>

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
京セラ株式会社 人材開発課(技術系担当) 田中・今野
E-mail: misato.tanaka.nf@kyocera.jp, shingo.konno.yb@kyocera.jp
TEL: 075-604-3510 (直通)
※各コースへの応募書類ご郵送の際は、封筒に
「〇〇採用コース応募書類在中」と記載願います。

「職種別採用コース(推薦応募)の方」へ

応募、面談会については、プロダクト別採用コースと同じ流れ(マッチング面談有)
となります。

①マッチング面談の応募締切は、プロダクト別採用コースと同じ日程です。
②マッチング面談日は、プロダクト別採用コースとは別日となります。
※応募いただいた方に、別途ご連絡いたします。

※最終選考は、プロダクト別採用コースのマッチング成立の方と同様に、
6月以降を予定しています。

「6月1日以降に学校推薦で応募をされる場合の留意事項」

①配属先のプロダクト、職種を限定しない応募方法に変更になる可能性があります。
応募の際に担当までお問い合わせください。
②推薦応募が決定されましたら、就職担当教授もしくはキャリアセンター様より
弊社技術系採用担当までご連絡ください。
③応募書類については、「マッチング面談会申込方法」と同様に、
データ入力・送信を、マイページより行ってください。

自己紹介シート記入要領

【応募に際しての留意事項】

☆ 応募前に必ず弊社採用HPより、エントリーください。 URL: <http://www.kvocera.co.jp/recruit/new/>
エントリー後、ご自身のマイページより「自己紹介シート」及び「成績情報」を入力してください。

＜自己紹介シート必要情報の入力に際して＞

- (1) 「携わりたい技術分野」については、【技術分野】*表1より選択してご入力ください。(3つ以内)
- (2) 「希望するプロダクト及び職種」については、【プロダクト及び職種】*表2よりご選択ください。
 - ①プロダクト別採用コースの方 : プロダクト名称①～④から、2つご選択ください。 ※1つのみでの受験を強く希望される方は1つのみで結構です。
 - ②職種別採用コースの方 : 職種名称⑤～⑧から、1つのみご選択ください。
- (3) 「卒業・修了研究概要とねらい」について、研究テーマが未定の方・学部生の方は、現在の専攻に基づき最も関心を持っている研究分野もしくは最もご自身が得意とする分野とその理由についてご入力ください。

【携わりたい技術分野及びプロダクト詳細】 ※マイページでも確認いただけます。

◆表1 技術分野

・無機材料技術	・薄膜成膜技術	・パワーエレクトロニクス技術	・画像認識/画像処理技術	・振動/熱/流体関連技術
・有機材料技術	・微細加工技術	・電気特性評価技術	・ソフトウェア技術	・電池関連技術
・金属材料技術	・金属加工技術	・制御工学技術	・シミュレーション技術	・人工知能関連技術
・応用化学技術	・電気回路技術	・機械設計技術	・分析技術	・特許/知的財産管理技術
・材料特性評価技術	・電子回路技術	・機構設計技術	・信頼性工学技術	・情報システム管理技術
・セラミックプロセス技術	・高周波回路技術	・機械加工技術	・CAD/CAM技術	・施設管理技術
・電気化学技術	・情報通信技術	・光学設計技術	・IE/VE技術	・安全防災管理技術

※上記の◆技術分野について、該当する技術分野が無い場合には、自由にご記入ください。

◆表2 プロダクト及び職種

各プロダクト及び職種の内容については、「京セラ会社概要パンフレット」「京セラ新卒採用HP 製品紹介ページ」をご確認ください。
※HPの製品紹介ページについては、新卒採用HP内の「京セラについて」のタブよりご確認ください。

プロダクト及び職種 ※①～⑧については、どの事業にも、研究、開発・設計、製造技術、生産技術、品質評価技術等の職種があります。	専攻分野					
	電気・電子/物理系	機械・制御/物理系	情報・通信系	無機化学・材料系	有機化学・材料系	金属・結晶・半導体系
専攻分野 ※該当する専攻分野がない方は、担当までご相談ください。						
ファイナセラミック部品関連						
①ファイナセラミック部品 半導体・液晶製造装置用大型部品、サファイア単結晶製品、生活文化・産業機械用部品、環境・エネルギー関連用部品、医療機器用部品 等	○	○		○	○	○
②車載用部品・車載カメラ エンジン部品、カーエレクトロニクス部品、車載カメラモジュール 等	○	○	○	○	○	○
半導体部品関連						
③セラミックパッケージ・基板 ＜パッケージ＞ 半導体デバイス用パッケージ、通信デバイス用高周波パッケージ、電子部品用小型パッケージ、光半導体用パッケージ 等 ＜基板＞ 車載エンジン制御用セラミック基板、LEDランプモジュール用セラミック基板 等	○	○	○	○	○	○
④有機パッケージ・基板 ＜パッケージ＞ サーバー・ルーター・携帯端末用多層パッケージ 等 ＜基板・配線板＞ 携帯端末・車載用通信モジュール基板、パソコン・携帯端末用高密度配線板、ハイエンドサーバー・通信システム用大型基板 等	○		○	○	○	○
⑤ケミカル材料 半導体関連樹脂材料/半導体封止材料、半導体・電子部品組立材料、化成品、熱硬化性成型材料、機能性シート 等		○		○	○	
ファイナセラミック技術応用関連						
⑥切削工具 超硬合金セラミックハイブリッド切削チップ、超硬合金ドリル、工業用精密ナイフ 等	○	○		○		○
⑦医療機器 人工関節、デンタルインプラント 等		○		○	○	○
⑧宝飾・応用商品 人工再結晶化宝石、ジュエリー装身具、セラミック応用キッチン用品、セラミック応用ステーションナリー・日用品 等		○		○	○	○
⑨エネルギーデバイス・システム 燃料電池SOFC、リチウムイオン蓄電システム、HEMS(家庭用エネルギー管理システム) 等	○	○	○	○		○
電子デバイス関連						
⑩電子部品 コンデンサ、コネクタ、パワーデバイス(SAWフィルタ、高周波通信モジュールも含む)、水晶デバイス(水晶振動子、水晶発振器、光デバイス) 等	○	○		○	○	○
⑪プリンティングデバイス 高速商業用インクジェットプリントヘッド、サーマルプリントヘッド、トナー方式プリンタ用アモルファスシリコン感光ドラム 等	○	○		○	○	○
通信機器関連						
⑫通信機器 高耐久スマートフォン、携帯電話、IoT用小型通信モジュール 等	○	○	○	○		
ソフトウェア関連						
⑬ソフトウェア開発 組み込みソフト開発、IoT・センサーネットワーク等の情報基盤技術開発、ビッグデータ・ヘルスケア等のサービスアプリケーション開発、画像処理・画像認識開発 人工知能等の先端ソフトウェア技術開発 等	○	○	○			
生産技術開発関連						
⑭生産技術開発・精機 メカトロ技術開発、製造プロセス開発、設備製造(開発・設計・製作) 等	○	○	○	○	○	○
その他技術関連						
⑮特許・知的財産 事業戦略の一翼を担う知財戦略の立案・実行、自社発明の権利化・保護、他社とのライセンス契約関連業務 等	○	○	○	○	○	○
⑯情報システム・ネットワークエンジニア 社内情報システムネットワークの企画・開発、保守管理 等	○		○			
⑰施設管理 省エネ推進、電気設備設計、保守 等	○	○	○	○	○	○
⑱安全防災 労働安全衛生管理、消防防災管理、健康管理業務 等	○	○	○	○	○	○